

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2026 年 7 月 30 日)

证券代码：688110证券简称：东芯股份

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☒ 其他（策略会）
参与单位名称	富邦证券、国泰世华银行、国泰投信、元大投信
活动时间	2026 年 7 月 20 日
活动地点	策略会、反路演
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：唐超宇、杨丽颖
投资者关系 活动主要内容介绍	1：公司扩产情况如何？ 答：公司采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发设计与销售。公司采取“本土深度、全球广度”的供应链策略，与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了长期稳定的战略合作关系。2026 年，公司正有序加大主要存储产品线的生产与备货力度，以匹配下游市场需求的持续复苏。公司将根据市场供需变化和客户订单情况，动态调整投片规模，保障产能供应的稳定性与连续性。 2：具身智能发展对公司业务的影响如何？ 答：公司是中国大陆少数同时具备 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 三大存储芯片自主研发设计能力的企业，聚焦中小容量存储芯片的设计、研发及销售。公司产品可广泛应用于网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与智能化、汽车电子等领域，具备低功耗、高可靠性等优势。在具身智能应用场景，公司已有部分存储解决方案在研发推进中。具身智能等新兴领域的逐步发展，将进一步打开利基型存储的应用空间，但短期内对公司业绩的影响相对有限，敬请注意投资风险。公司将持续关注该新兴领域的发展趋势，积极匹配客户需求。 3：公司海内外的晶圆产能占比分别是多少？

	答：公司采用 Fabless 模式运营，与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了互助、互利、互信的合作关系，构建了“本土深度、全球广度”的供应链体系，目前产能供应稳定。在存储芯片方面，公司主要同中国大陆以及中国台湾的代工厂进行合作。公司会根据市场需求与客户订单情况，动态调整投片规模。
日期	2026年7月30日